

2025年3月期 第1四半期（2024年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年8月8日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

第1四半期 連結決算の概要

2024年8月8日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



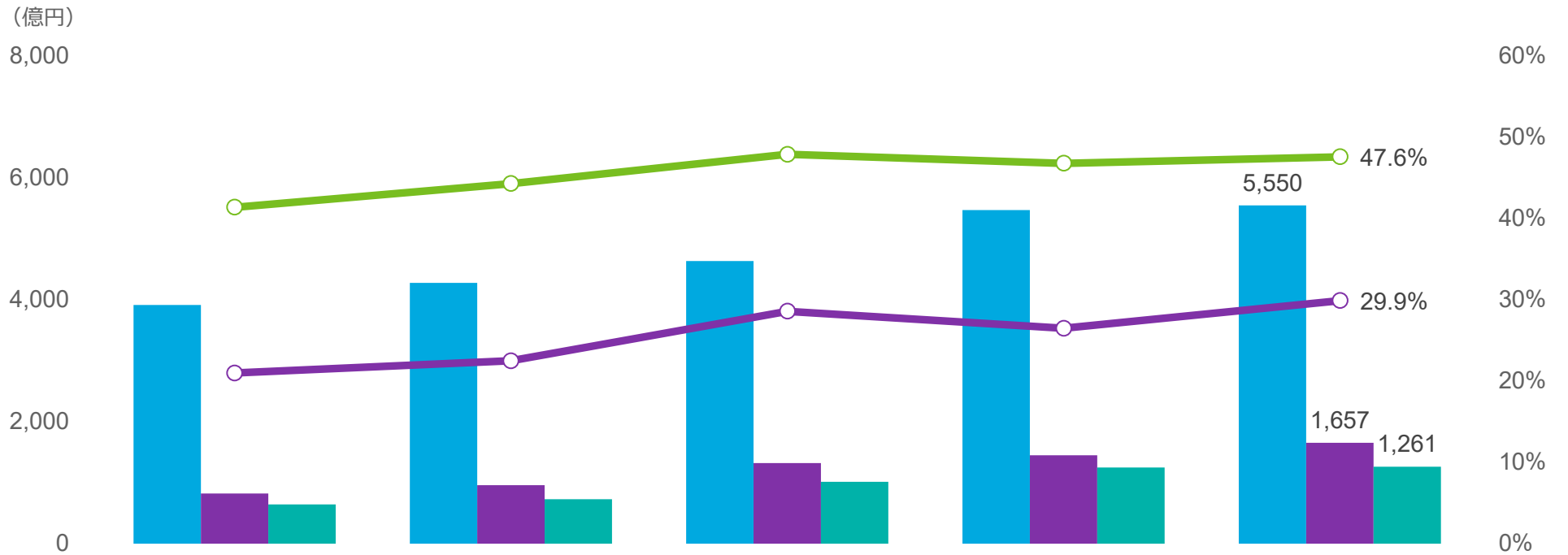
損益状況（四半期）

（億円）

	FY2024				FY2025	vs. Q4 FY2024	vs. Q1 FY2024
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
売上高	3,917	4,278	4,636	5,472	5,550	+1.4%	+41.7%
売上総利益	1,623	1,897	2,221	2,561	2,640	+3.1%	+62.7%
売上総利益率	41.4%	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%	+0.8pts	+6.2pts
販管費	798	935	896	1,108	982	-11.4%	+23.0%
営業利益	824	961	1,324	1,452	1,657	+14.1%	+101.1%
営業利益率	21.0%	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%	+3.4pts	+8.9pts
税金等調整前当期純利益	830	981	1,344	1,578	1,672	+5.9%	+101.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	643	731	1,015	1,249	1,261	+1.0%	+96.2%
研究開発費	436	510	497	584	534	-8.5%	+22.4%
設備投資額	393	176	318	329	239	-27.2%	-39.1%
減価償却費	106	125	138	153	132	-14.0%	+24.5%

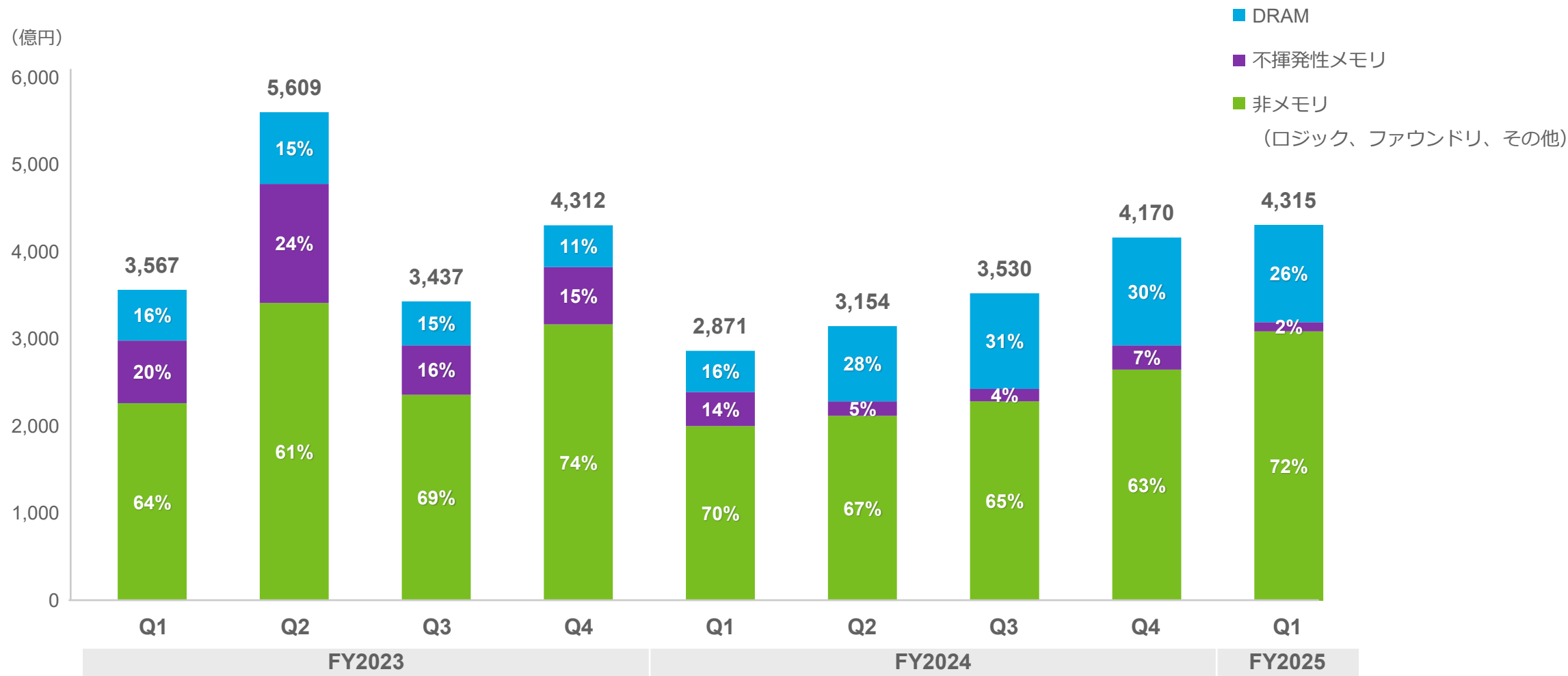
1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）



	FY2024				FY2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 売上高	3,917	4,278	4,636	5,472	5,550
■ 営業利益	824	961	1,324	1,452	1,657
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	643	731	1,015	1,249	1,261
○ 売上総利益率	41.4%	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%
○ 営業利益率	21.0%	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%

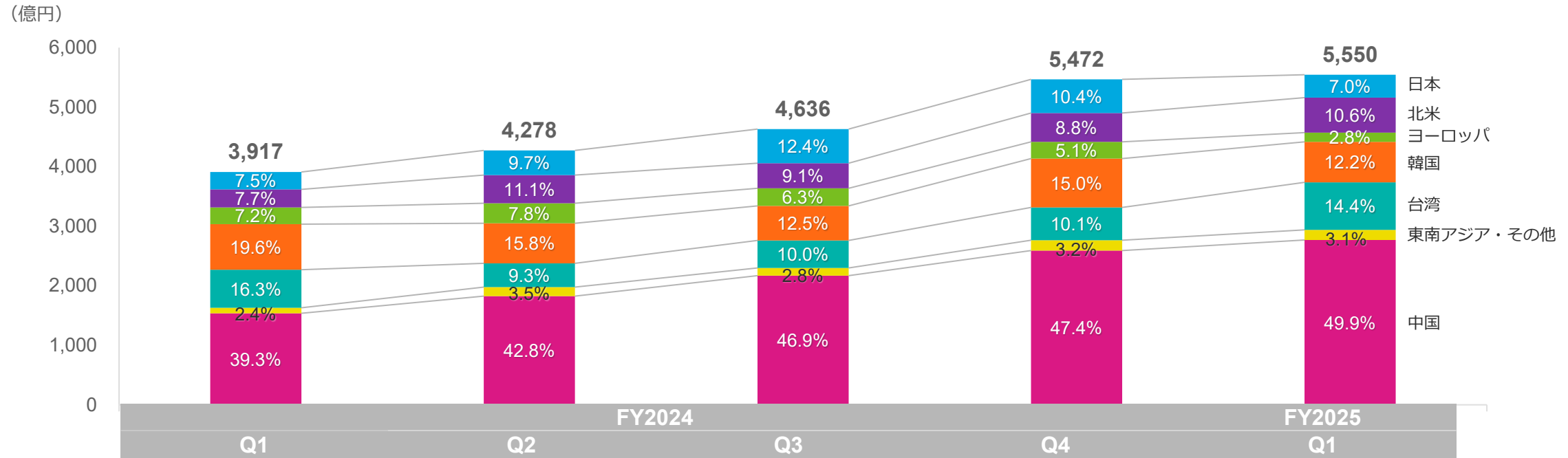
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



*1 SPE：半導体製造装置

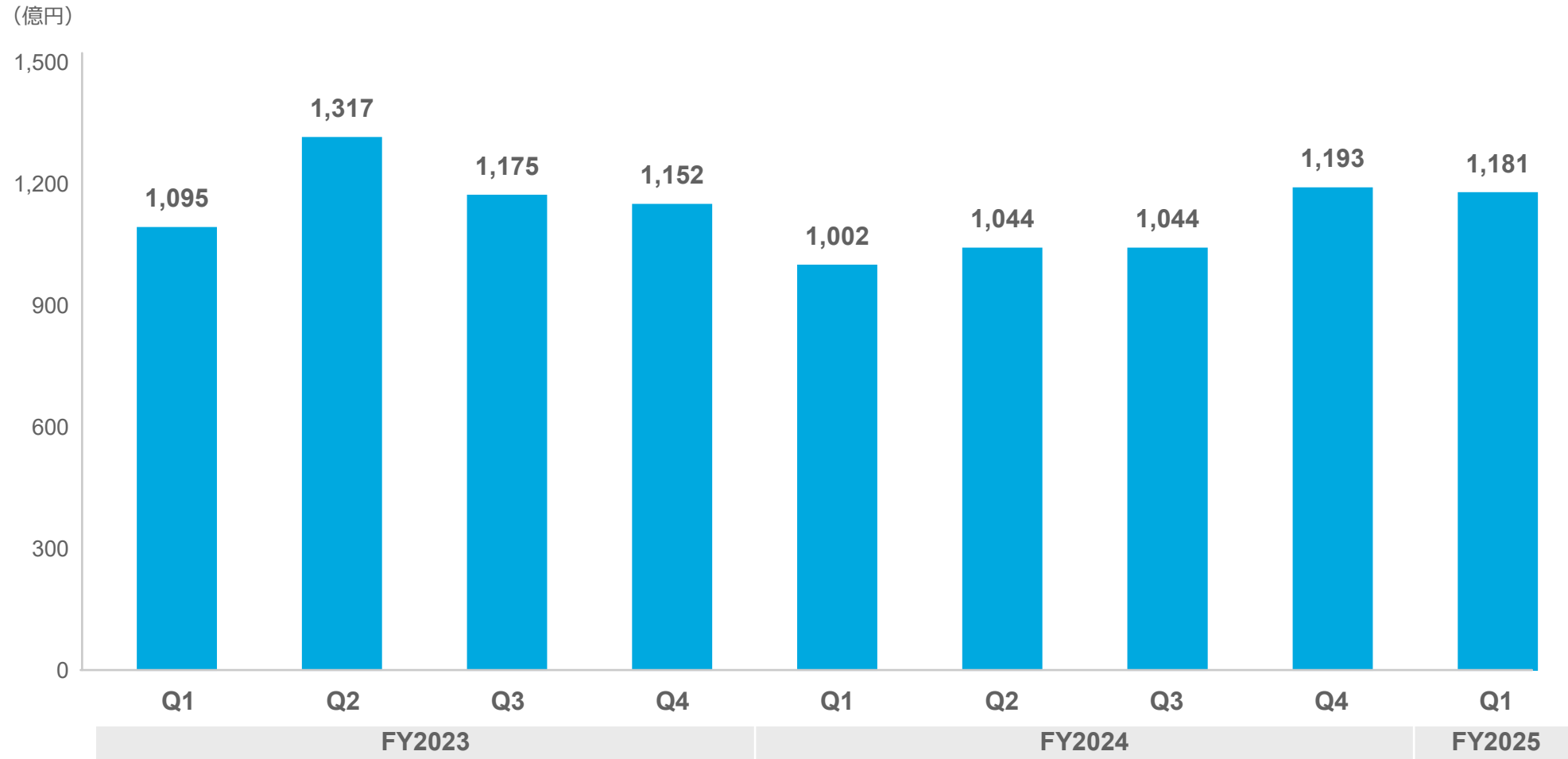
*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q1）



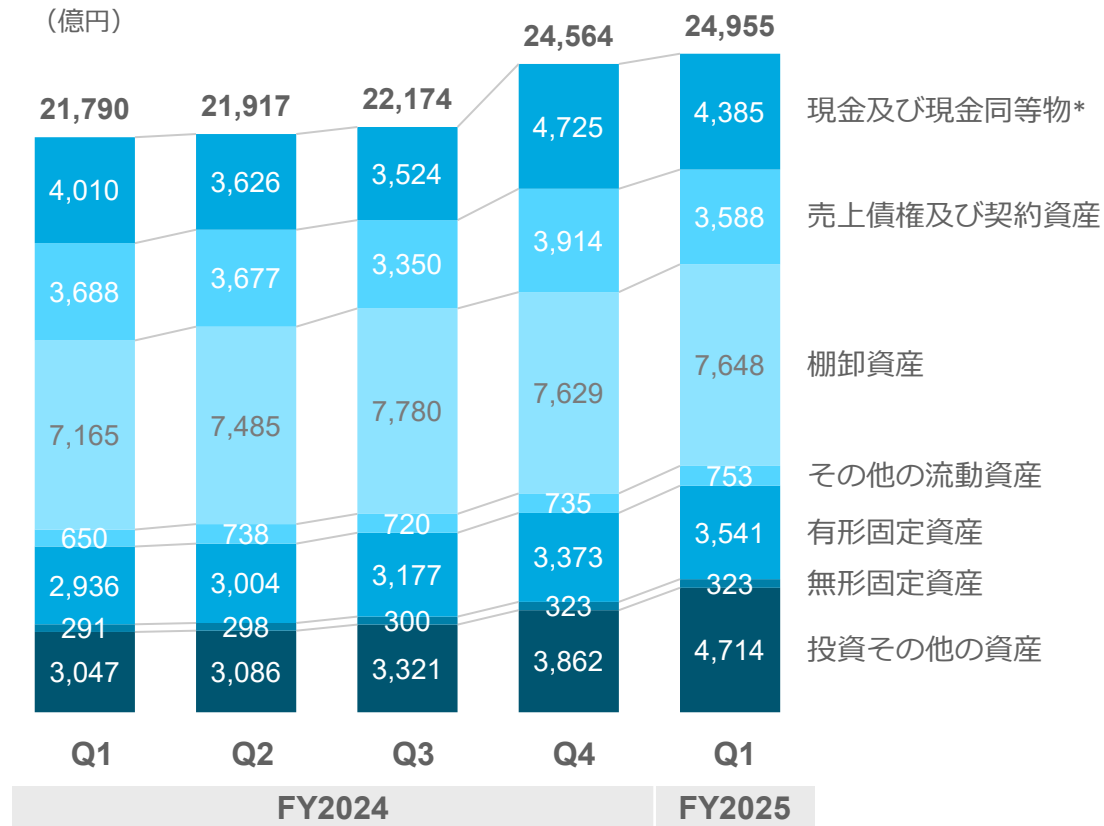
地域	FY2024				FY2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
日本	295	412	574	567	385
北米	301	474	421	483	590
ヨーロッパ	281	335	294	281	155
韓国	767	674	582	820	678
台湾	639	399	463	552	800
東南アジア・その他	92	151	127	175	170
中国	1,539	1,829	2,172	2,591	2,770

フィールドソリューション売上高（四半期）

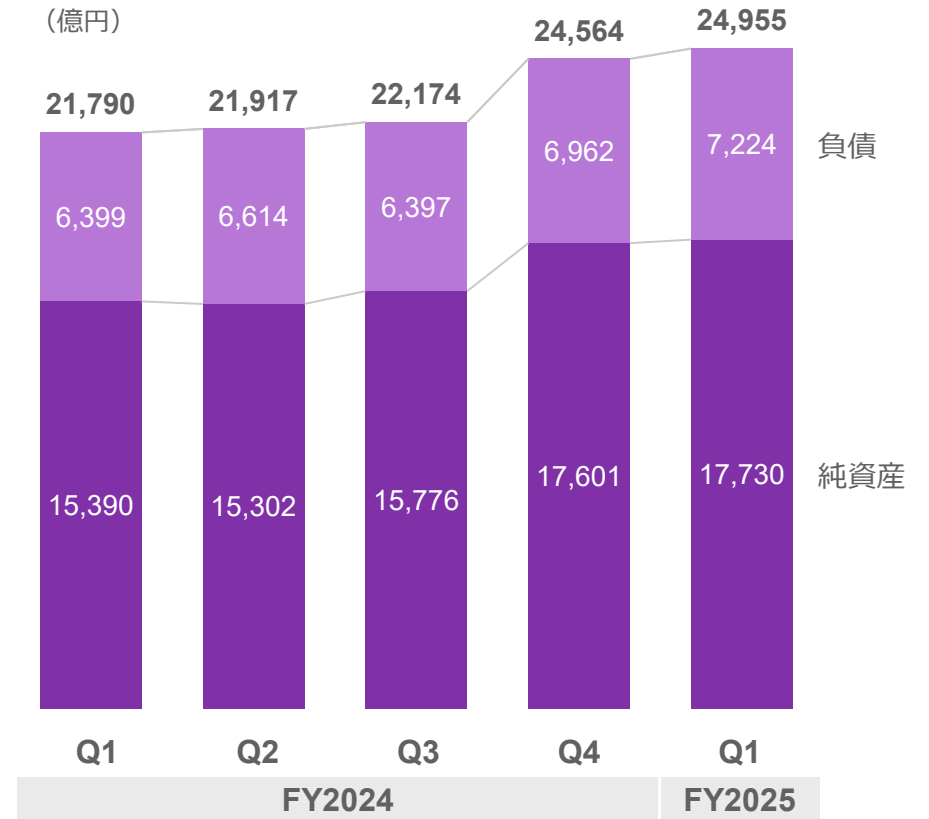


貸借対照表（四半期）

資産

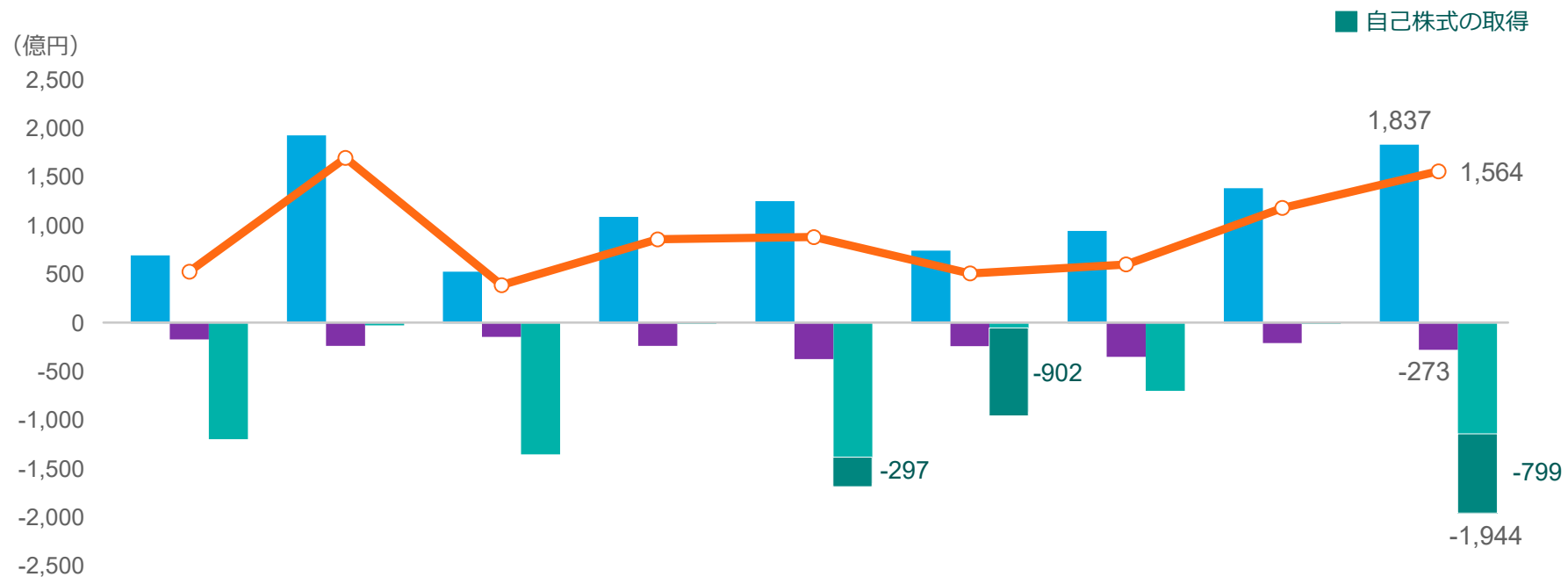


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023				FY2024				FY2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 営業キャッシュ・フロー	699	1,934	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-166	-231	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,191	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944
○ フリーキャッシュ・フロー*2	533	1,702	393	865	888	514	606	1,187	1,564
■ 手元資金残高*3	3,146	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

自己株式の取得状況

- 2024年6月30日までに取得終了
 - 取得した株式の総数 2,317,000 株
 - 株式の取得価額の総額 79,998,958,000 円

- ご参考（2024年5月10日開催 取締役会決議内容）
 - 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - 取得し得る株式の総数 350 万株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合0.8%）
 - 株式の取得価額の総額 800 億円（上限）
 - 取得する期間 2024年5月13日～2024年7月31日

事業環境および業績予想

2024年8月8日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



事業環境（2024年8月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2024：\$100B強と予測

- 旺盛なAIサーバー向け投資。PC・スマートフォン向けの稼働率も着実に回復基調へ
 - DDR5やHBM*1等の需要増によるDRAM向けの投資が活況
 - 最先端ロジック/ファウンドリにおいては、前工程装置のみならず、パッケージングやテストのニーズも急増

■ CY2025：二桁成長を期待

- 好調なAIサーバーに加え、PC・スマートフォンのAI搭載比率上昇を見込む
 - DRAMのさらなる拡大に加え、NANDも在庫調整が進捗し投資再開
 - 先端ロジック/ファウンドリ向けの設備投資も増加し、成熟向け投資の一服感をオフセット

➔ 大容量・超高速・低消費電力の実現に向けた技術革新が進展

GAA*2、Backside PDN*3、HBM、三次元実装におけるテスト工程（ウェーハプローバ）など、TELのビジネス機会は拡大

*1 HBM（High Bandwidth Memory）

：高帯域幅DRAM

*2 GAA（Gate All Around）

：トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

*3 Backside PDN（Power Delivery Network）

：電源供給配線をシリコンの裏面に配置する構造

FY2025 Q1 事業進捗

- 売上・利益ともに計画を上回る
 - 売上5,550億円、営業利益1,657億円、営業利益率29.9%
- 戦略製品によるPOR*獲得・開発評価も順調
 - DRAM向けコンダクターエッチング、最先端ロジック向け洗浄装置で開発POR獲得
 - NAND向け極低温エッチング、ボンディングなど、量産に向けた開発・評価が着実に進捗
- 先端パッケージングやテストの引き合い急増
 - 塗布現像、エッチング、バッチ成膜、ボンディング、ウェーハプロローバ等、幅広くリクエストあり
- 半導体の技術革新に貢献する新製品をリリース
 - 枚葉成膜装置「Episode™シリーズ」：微細化や3次元化、成膜材料の多様化のニーズに対応
 - ガスクラスタースタービーム装置「Acrevia™」：
低ダメージで極微細な線幅加工と形状補正をおこなう。EUVパターンニング工程のコストを低減
- 約800億円の自己株式取得を完了

* POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

FY2025 業績予想

FY2025 業績予想

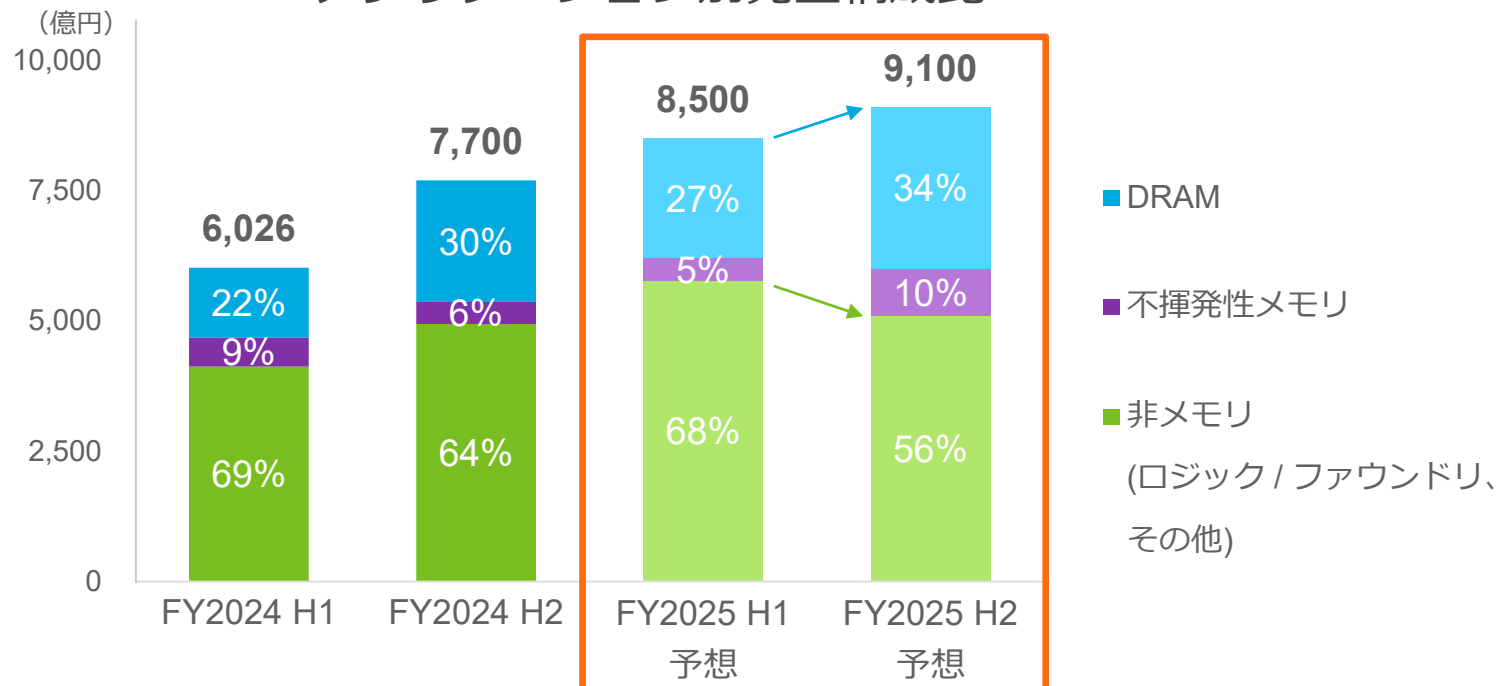
(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025 (新予想)				
		H1	H2	通期	通期 修正額	通期 対前期増減
売上高	18,305	11,000	12,000	23,000	+1,000	+25.6%
売上総利益	8,302	5,040	5,680	10,720	+500	+29.1%
売上総利益率	45.4%	45.8%	47.3%	46.6%	+0.1pts	+1.2pts
販管費	3,740	2,160	2,290	4,450	+50	+19.0%
研究開発費	2,028	1,210	1,320	2,530	+30	+24.8%
研究開発費以外の販管費	1,711	950	970	1,920	+20	+12.2%
営業利益	4,562	2,880	3,390	6,270	+450	+37.4%
営業利益率	24.9%	26.2%	28.3%	27.3%	+0.8pts	+2.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	2,900	3,400	6,300	+460	+33.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,180	2,600	4,780	+330	+31.3%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	472.61	-	1,036.94	+75.75	+253.19

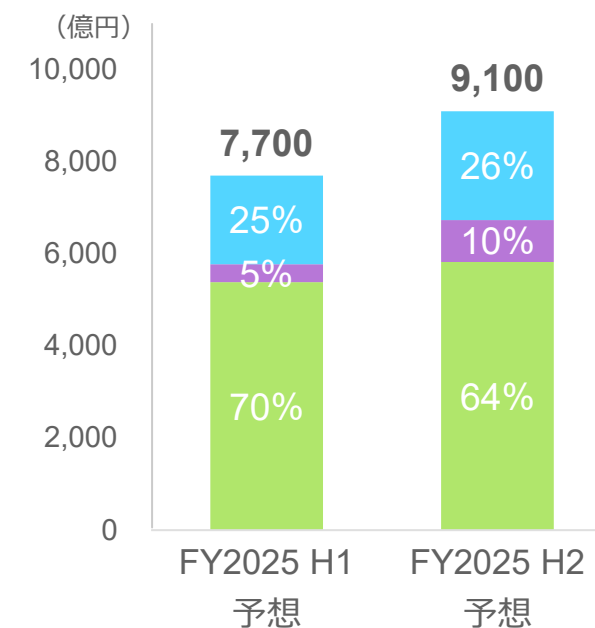
Q1実績および最新の市場動向を反映し、業績予想を上方修正。
 FY2025は過去最高の売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、
 当期純利益およびEPSを見込む

FY2025 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



【ご参考】5月決算発表時 予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

最新の市場動向を反映し、メモリとロジックの売上比率を修正

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟

成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県斐崎市
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター

成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟

コート/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置



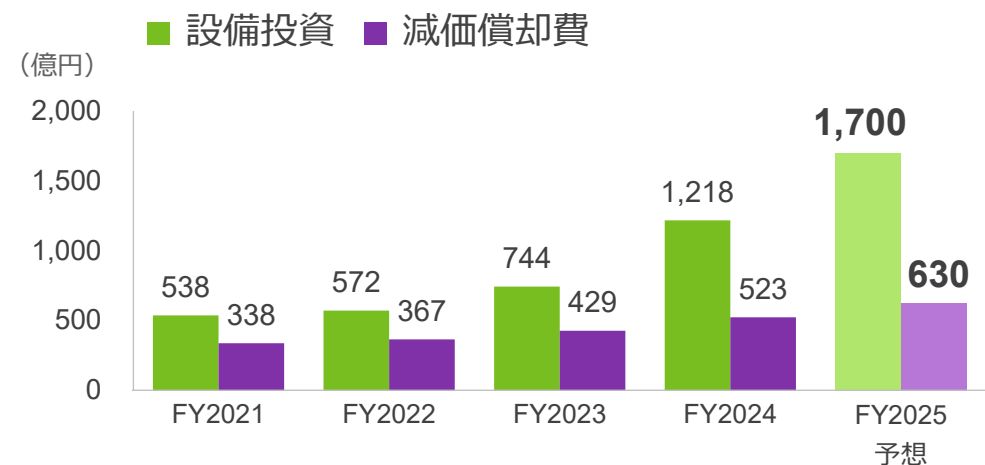
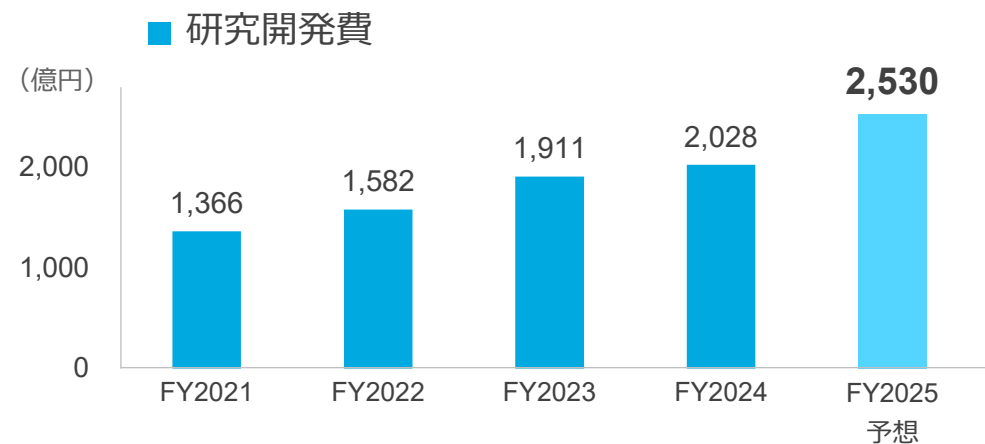
熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

新開発棟

エッチング装置



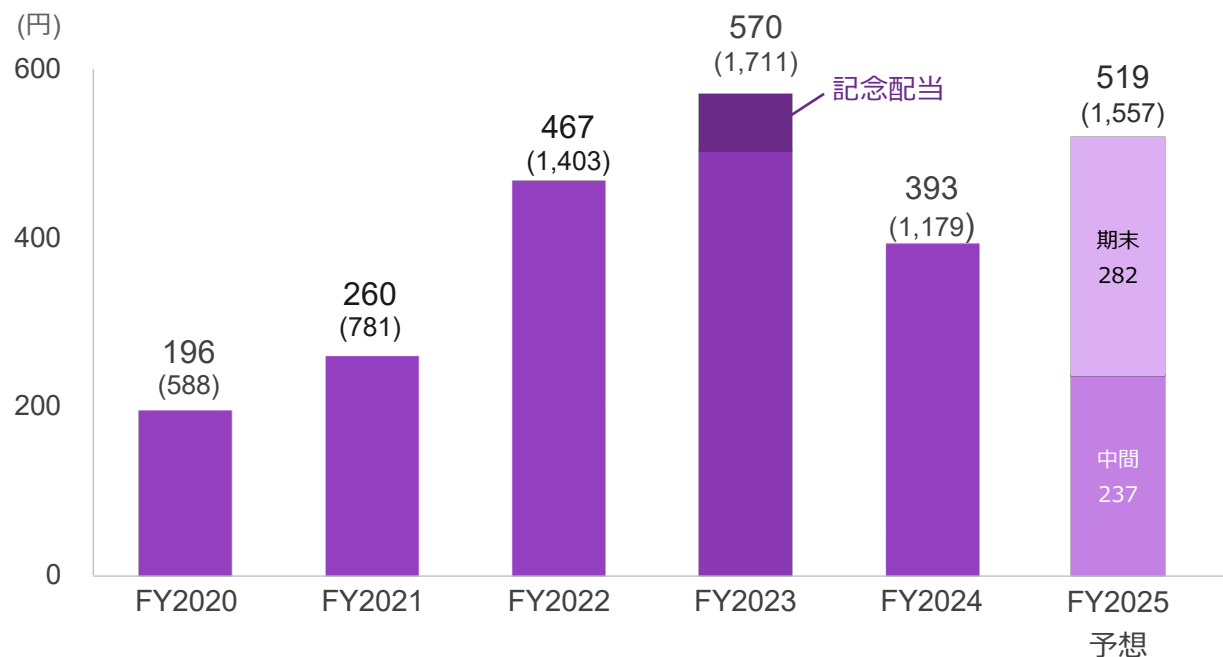
宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

FY2025 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

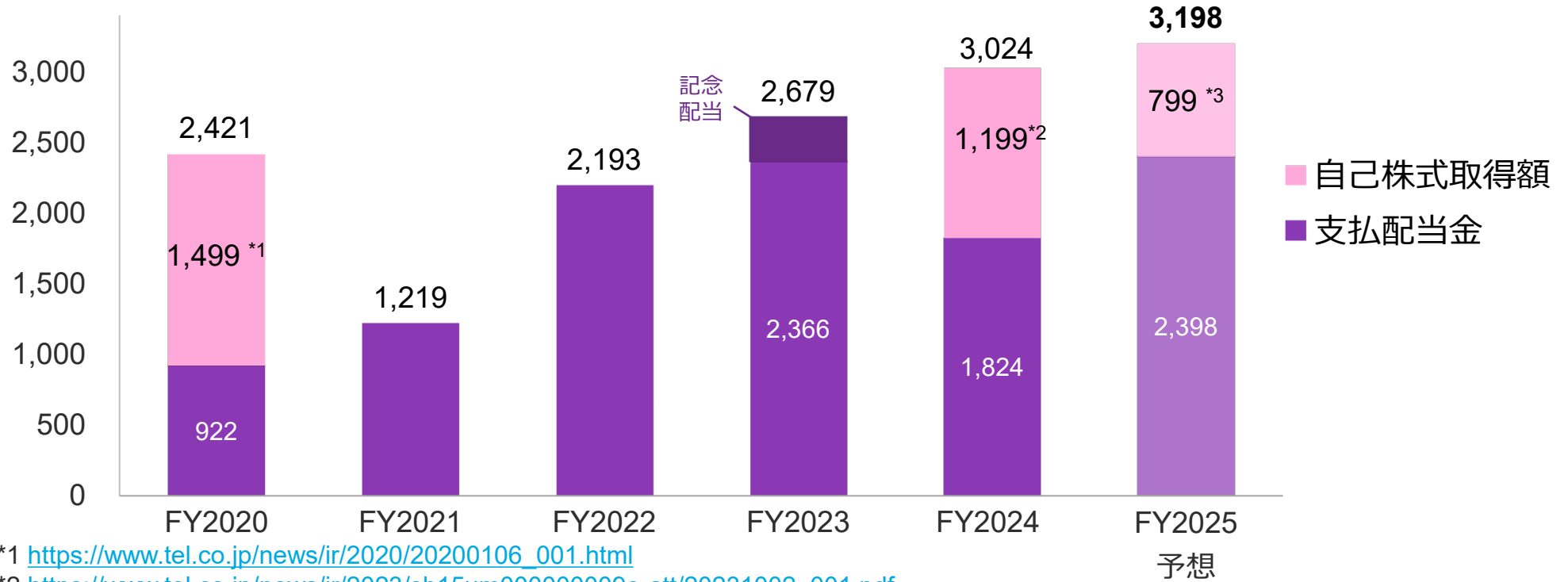
*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は519円を予定

総還元額

(億円)



*1 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tln2lq00000000c0-att/20240701_001.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高レベルの総還元額を見込む

TEL

TOKYO ELECTRON

本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。